

(19)



(11)

EP 3 185 655 B8

(12)

KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 73

(51) Internationale Patentklassifikation (IPC):
H05K 1/02 ^(2006.01) **H05K 1/03** ^(2006.01)
H05K 3/00 ^(2006.01) **H05K 3/02** ^(2006.01)

(48) Corrigendum ausgegeben am:
03.01.2024 Patentblatt 2024/01

(52) Gemeinsame Patentklassifikation (CPC):
H05K 1/0266; H05K 1/0269; H05K 1/0306;
H05K 3/0052; H05K 3/0097; H05K 3/022;
H05K 2201/0969; H05K 2201/09927;
H05K 2201/09936; H05K 2203/0369;
H05K 2203/107

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
29.11.2023 Patentblatt 2023/48

(21) Anmeldenummer: **16205606.3**

(22) Anmeldetag: **21.12.2016**

(54) **VERFAHREN ZUR INDIVIDUELLEN CODIERUNG VON METALL-KERAMIK-SUBSTRATEN**

METHOD FOR THE INDIVIDUAL ENCODING OF METAL-CERAMIC SUBSTRATES

PROCÉDÉ DE CODAGE INDIVIDUEL DE SUBSTRATS MÉTAL-CÉRAMIQUES

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

• **Rogg, Alexander**
92724 Trabitz (DE)

(30) Priorität: **22.12.2015 EP 15201883**

(74) Vertreter: **Gille Hrabal Partnerschaftsgesellschaft**
mbB
Patentanwälte
Brucknerstraße 20
40593 Düsseldorf (DE)

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
28.06.2017 Patentblatt 2017/26

(73) Patentinhaber: **Heraeus Electronics GmbH & Co.**
KG
63450 Hanau (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
WO-A1-03/078353 **DE-A1- 3 113 031**
DE-C1- 19 829 986 **GB-A- 2 343 059**
US-A1- 2009 223 435

(72) Erfinder:
• **Wacker, Richard**
96135 Stegaurach (DE)

EP 3 185 655 B8

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).
